



112 年度工研院電子與光電系統研究所 無線通訊、異質構裝及智慧製造技術等 相關研發成果讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強而有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含 78 案 167 件專利（以下簡稱：「讓與標的」）。

「讓與標的」共分為：

- （一）無線通訊：25 案 55 件；
- （二）Peripheral 與測試電路：6 案 16 件；
- （三）半導體異質構裝：11 案 25 件；
- （四）軟性電子：2 案 4 件；
- （五）智慧製造與辨識：11 案 20 件；
- （六）取像與影像處理技術：15 案 27 件；
- （七）半導體光源：8 案 20 件。

「讓與標的」並無共有專利，「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

（一）公開說明會將於民國（下同）112 年 2 月 16 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。

（二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 112 年 2 月 15 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「112 年度工研院電子與光電系統研究所無線通訊、異質構裝及智慧製造技術等相關研發成果讓與案：公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 112 年 2 月 15 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會議資訊。



(三) 自本讓與案公告日起至截標日 112 年 3 月 1 日 17 時整 (含) 止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

(一) 本讓與案採通訊或親送方式投標。

投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同：

1. (密封) 價格封。
2. 押標金。
3. 公司設立證明文件 (如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本)。
4. 近兩年財報資料。
5. 公司基本資料暨運用規劃說明表。
6. 商業營運計畫書一式 7 份。(若投標多案，廠商之商業營運計畫書得僅檢附一式 7 份，惟須於商業營運計畫書中敘明不同之標的運用規劃模式。)

(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「112 年度工研院電子與光電系統研究所無線通訊、異質構裝及智慧製造技術等相關研發成果讓與案投標」，於截標日 112 年 3 月 1 日 17 時整 (含) 前 (以送達收據為憑) 掛號寄達或親送至：

310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工研院技轉法律中心 桂小姐收。

(二) 廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表中敘明境外實施金額。

(三) 商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1. 公司背景／關係企業／合作夥伴簡介 (20%)
2. 公司財務狀況 (20%)
3. 公司營運／研發能力 (20%)
4. 「讓與標的」運用規劃 (30%)
5. 國內產業效益 (10%)

(如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等)

(四) 投標方式：本讓與案採一案一標，即同一案專利不分開投標／開標。(「讓與標的」以同一發明為一案。)

(五) 本讓與案不得共同投標或重複投標。

(六) 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

(七) 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。



六、押標金：

- (一) 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。於決標當日依第八條第(六)項約定加價後得標者，應於決標次日起 10 個工作日內補足押標金。若未於期限內補足者，工研院得沒收押標金並取消得標資格，但經工研院同意者，不在此限。
- (二) 押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
- (三) 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

- (一) 投標時間截止後之投標。
- (二) 開標前業已公告停止本讓與案交易程序。
- (三) 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
- (四) 投標單附加任何成交條件者。
- (五) 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
- (六) 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標時未能補足者，其投標為無效。
- (七) 投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果(包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果)轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及／或工研院同意者，不在此限。
- (八) 投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方法：

- (一) 分為初審(開標日為 112 年 3 月 3 日)及複審(決標日為 112 年 3 月 10 日)，投標廠商於通過初審後，始能進入複審。會另行通知投標廠商，請廠商依通知時間進行複審。
- (二) 得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。
- (三) 初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、商業營運計畫書進行書面審查及確認。
- (四) 投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會會議就商業營運計畫書進行複審，投標廠商於決標日應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔等相關文件。
- (五) 投標廠商若有境外實施需求，除於公司基本資料暨運用規劃表中敘明境外實施金額，並於複審時報告說明。
- (六) 複審時，工研院開標審議委員會會議將同時開啟超過及格分之所有投標廠商價格封，將以投標廠商金額最高且高於底價者得標。若有二

(含)家以上投標廠商出價且皆無超過底價，則出價金額最高之廠商可優先有一次加價機會，若此加價仍無超過底價，之後則由所有投標廠商同時議價，所有投標廠商之間的同時比增價格以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二(含)家以上投標廠商總評比分數均超過及格分，投標金額亦均超過底價且相同，得提供投標廠商議價機會，並以高價者決標。比增價格以三次為限，若比增三次後之投標金額仍相同者，由工研院現場抽籤決定之。(議價時，若非投標廠商負責人出席，須填妥並提供委託代理授權書)

(七) 決標時將請律師到場監標。

(八) 決標後將個別通知投標廠商決標結果(不公告得標廠商)。

(九) 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。

九、契約事項：

(一) 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作日內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。

(二) 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經工研院同意者，不在此限)；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。

(三) 得標廠商與工研院簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。

(四) 遵守政府法令規定：得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定(包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定)。前述法令變動時，亦同。

(五) 得標廠商應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。

(六) 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本讓與案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。「讓與契約書」生效日：「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。

(七) 反授權約定：得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永

久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予經濟部或工研院。得標廠商嗣後若將「讓與標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人（以下簡稱「後手」）時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」再為專屬授權或讓與時亦同。

- (八) 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：
1. 工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；
 2. 工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；
 3. 工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。
- (九) 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本讓與案公告日之「讓與標的」現狀辦理本讓與案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。
- (十) 「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
- (十一) 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之政府法令規定，配合工研院向主管機關（包含但不限於經濟部技術處，以下同）為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及／或主管機關核准及

同意後始得為之：

- 1.得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；
- 2.得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
- 3.得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
- 4.得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

（十二）得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

- 1.得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
- 2.得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。
- 3.為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。

（十三）得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及／或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前書面通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。此外，若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與或輾轉讓與「讓與標的」予非專利實施實體（Non-Practicing Entity，以下簡稱「NPE」），或未經工研院及／或經濟部同意之受讓者（以下簡稱「未經同意之受讓者」），造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「讓與標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與後手之讓與契約，否則即視為將「讓與標的」讓與予「NPE」或「未經同意之受讓者」。

（十四）得標廠商應使所有「後手」遵守本條第七項至第九項、第十一項至第十六項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

（十五）基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協



議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院並取得書面同意。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

(十六) 得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

(十七) 得標廠商應盡力進行產品開發等運用「讓與標的」工作，倘得標廠商未能舉證於合理期間內有運用「讓與標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本讓與案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本讓與案公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或抵觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本讓與案公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心桂小姐

電話：+886-3-591-8009

傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：ManTing@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室



附件：專利清單

(一) 無線通訊：25 案 55 件

案次	件次	件編號	專利名稱	狀態	國家	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	契約運用
1	1	P62980009US	接收器	獲證	美國	12/536,644	US8364109	20130129	20310925	經濟部技術處	非專屬授權中
	2	P62980009TW	接收器	獲證	中華民國	98116066	TWI406512	20130821	20290513	經濟部技術處	非專屬授權中
2	3	P62960040TW	低雜訊放大器電路	獲證	中華民國	97138545	TWI327819	20100721	20281006	經濟部技術處	非專屬授權中
3	4	P62950035US	可程式化響應頻率選擇元件的校準裝置與方法	獲證	美國	11/761,365	US7627443	20091201	20271108	經濟部技術處	
	5	P62950035TW	可程式化響應頻率選擇元件的校準裝置與方法	獲證	中華民國	96105134	TWI331851	20101011	20270211	經濟部技術處	非專屬授權中
4	6	P62950016US	電源供應裝置及其操作模式決定單元與決定方法	獲證	美國	11/553,470	US7679346	20100316	20280723	經濟部技術處	
	7	P62950016TW	電源供應裝置及其操作模式決定單元與決定方法	獲證	中華民國	95126912	TWI325100	20100521	20260723	經濟部技術處	
5	8	P52990188US	注入式除頻器	獲證	美國	13/339,361	US8493105	20130723	20320126	經濟部技術處	
6	9	P52990187US	電感電容振盪器	獲證	美國	13/338,268	US8717112	20140506	20320427	經濟部技術處	
	10	P52990187TW	電感電容振盪器	獲證	中華民國	100123881	TWI450492	20140821	20310705	經濟部技術處	
7	11	P52990157US	消除平衡轉換放大器之雜訊的方法及其裝置	獲證	美國	12/971,307	US8410856	20130402	20310928	經濟部技術處	
	12	P52990157TW	消除平衡轉換放大器之雜訊的方法及其裝置	獲證	中華民國	100106505	TWI399032	20130611	20310224	經濟部技術處	
	13	P52990157CN	消除平衡-非平衡轉換放大器噪音的方法及其裝置	獲證	中國大陸	201110094569.5	CN102545790	20140924	20310406	經濟部技術處	
8	14	P52990147US	時脈偏移補償裝置	獲證	美國	13/114,030	US8384455	20130226	20310915	經濟部技術處	曾非專屬授權
	15	P52990147TW	時脈偏移補償裝置	獲證	中華民國	99143541	TWI449339	20140811	20301212	經濟部技術處	曾非專屬授權
9	16	P52990076US	以動態比較器為基礎的比較系統	獲證	美國	12/981,516	US8334717	20121218	20310530	經濟部技術處	
	17	P52990076TW	以動態比較器為基礎的比較系統	獲證	中華民國	99139552	TWI443969	20140701	20301116	經濟部技術處	
10	18	P52990032USD1	電流式類比基頻裝置	獲證	美國	13/530,126	US8441313	20130514	20300812	經濟部技術處	
	19	P52990032US	電流式類比基頻裝置	獲證	美國	12/855,716	US8427230	20130423	20310224	經濟部技術處	
	20	P52990032TW	電流式類比基頻裝置	獲證	中華民國	99123835	TWI427984	20140221	20300719	經濟部技術處	
11	21	P52030060US	功率轉換器之控制電路及最大功率點的追蹤方法	獲證	美國	14/594,164	US9257896	20160209	20350110	經濟部技術處	
	22	P52030060TW	功率轉換器之控制電路及最大功率點的追蹤方法	獲證	中華民國	103141422	TWI545418	20160811	20341127	經濟部技術處	曾非專屬授權
	23	P52030060CN	功率轉換器的控制電路及最大功率點的追蹤方法	獲證	中國大陸	201410781028.3	CN105790617	20180713	20341215	經濟部技術處	
12	24	P52030007US	訊號比較裝置及其控制方法	獲證	美國	14/729,063	US9395746	20160719	20350602	經濟部技術處	
	25	P52030007TW	訊號比較裝置及其控制方法	獲證	中華民國	103142598	TWI554042	20161011	20341207	經濟部技術處	非專屬授權中
	26	P52030007CN	信號比較裝置及其控制方法	獲證	中國大陸	201510433421.8	CN105680832	20190419	20350721	經濟部技術處	非專屬授權中
13	27	P52010210TW	栓鎖器與其操作方法與比較器	獲證	中華民國	102131815	TWI500266	20150911	20330903	經濟部技術處	
14	28	P52010074US	電流重複使用除頻器及其方法與所應用的電壓控制振盪器模組以及鎖相迴路	獲證	美國	13/727,612	US8829966	20140909	20321226	經濟部技術處	曾非專屬授權
	29	P52010074TW	電流重複使用除頻器及其方法與所應用的電壓控制振盪器模組以及鎖相迴路	獲證	中華民國	101143706	TWI508428	20151111	20321121	經濟部技術處	曾非專屬授權
15	30	P52010056US	栓鎖裝置及其應用	獲證	美國	13/798,129	US9190987	20151117	20330312	經濟部技術處	
	31	P52010056TW	栓鎖裝置及其應用	獲證	中華民國	101142275	TWI501558	20150921	20321112	經濟部技術處	



案次	件次	件編號	專利名稱	狀態	國家	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	契約運用
16	32	P52010054US	具有等化功能之動態比較器	獲證	美國	13/727,533	US8957706	20150217	20330107	經濟部技術處	
	33	P52010054TW	具有等化功能之動態比較器	獲證	中華民國	101135481	TWI506958	20151101	20320926	經濟部技術處	
17	34	P52000202US	射頻前端電路及其操作方法	獲證	美國	13/584,828	US8774744	20140708	20320822	經濟部技術處	
	35	P52000202TW	射頻前端電路及其操作方法	獲證	中華民國	101113993	TWI465033	20141211	20320418	經濟部技術處	
18	36	P52000195US	電壓控制振盪器模組以及振盪訊號產生方法	獲證	美國	13/558,360	US8723609	20140513	20320725	經濟部技術處	
	37	P52000195TW	電壓控制振盪器模組以及振盪訊號產生方法	獲證	中華民國	101108384	TWI482426	20150421	20320312	經濟部技術處	
19	38	P52000194US	時間交錯式類比數位轉換器之時序校正電路及時序校正方法	獲證	美國	13/596,744	US8604954	20131210	20320827	經濟部技術處	非專屬授權中
	39	P52000194TW	時間交錯式類比數位轉換器之時序校正電路及時序校正方法	獲證	中華民國	101109192	TWI489784	20150621	20320315	經濟部技術處	非專屬授權中
	40	P52000194CN	時間交錯式模擬數位轉換器之時序校正電路及方法	獲證	中國大陸	201210133146.4	CN103312327	20160601	20320427	經濟部技術處	非專屬授權中
20	41	P52000128US	類比數位轉換裝置及其轉換方法	獲證	美國	13/410,303	US8502722	20130806	20320301	經濟部技術處	
	42	P52000128TW	類比數位轉換裝置及其轉換方法	獲證	中華民國	100148306	TWI462487	20141121	20311222	經濟部技術處	
	43	P52000128JP	類比數位轉換裝置及其轉換方法	獲證	日本	2012-151168	JP5412561	20131115	20320704	經濟部技術處	
	44	P52000128CN	模擬數位轉換裝置及其轉換方法	獲證	中國大陸	201210054114.5	CN103178854	20160608	20320301	經濟部技術處	
21	45	P52000116US	數位類比轉換器的元素的權重的估算方法、裝置及應用其之逐次逼近暫存器類比數位轉換器	獲證	美國	13/338,214	US8502723	20130806	20320306	經濟部技術處	
	46	P52000116TW	數位類比轉換器的元素的權重的估算方法、裝置及應用其之逐次逼近暫存器類比數位轉換器	獲證	中華民國	100140408	TWI434517	20140411	20311103	經濟部技術處	
	47	P52000116CN	權重的估計方法、裝置及應用其的模擬數位轉換器	獲證	中國大陸	201110415198.6	CN103095299	20160120	20311212	經濟部技術處	
22	48	P51990102US	具有開槽的天線	獲證	美國	12/963,935	US8610626	20131217	20311031	經濟部技術處	
	49	P51990102TW	具有開槽的天線	獲證	中華民國	99143085	TWI482358	20150421	20301208	經濟部技術處	
	50	P51990102CN	天線及傳輸或接收無線電信號中的至少一個的方法	獲證	中國大陸	201110208959.0	CN102544698	20160106	20310724	經濟部技術處	
23	51	P51990100TW	萃取材料介電常數的裝置及其方法	獲證	中華民國	99139970	TWI400457	20130701	20301118	經濟部技術處	
24	52	P18940023US	具負阻抗補償之轉阻放大器	獲證	美國	11/369,286	US7453322	20081118	20260702	經濟部技術處	
	53	P18940023CN	具有負阻抗補償功能的轉阻放大器	獲證	中國大陸	200610004911.7	CN100536325	20090902	20260110	經濟部技術處	
25	54	P18930001US	高頻放大器	獲證	美國	10/983,411	US7157976	20070102	20250124	經濟部技術處	
	55	P18930001CN	高頻放大器	獲證	中國大陸	200410070168.6	CN100446414	20081224	20240803	經濟部技術處	

(二) Peripheral 與測試電路：6 案 16 件

案次	件次	件編號	專利名稱	狀態	國家	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	契約運用
26	56	P62960027USC1	系統單晶片電路測試架構之測試裝置與方法	獲證	美國	13/404,365	US8555123	20131008	20290502	經濟部技術處	
27	57	P52990020USD1	電荷域濾波器及其頻寬補償電路	獲證	美國	13/659,930	US8487694	20130716	20300707	經濟部技術處	
	58	P52990020US	電荷域濾波器及其頻寬補償電路	獲證	美國	12/832,976	US8324961	20121204	20310203	經濟部技術處	非專屬授權中



案次	件次	件編號	專利名稱	狀態	國家	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	契約運用
27	59	P52990020TWC1	電荷域濾波裝置及頻寬補償電路	獲證	中華民國	99126260	TWI443966	20140701	20300805	經濟部技術處	非專屬授權中
	60	P52990020CN	電荷域濾波裝置及其頻寬補償電路	獲證	中國大陸	201010220004.2	CN102315832	20140423	20300630	經濟部技術處	非專屬授權中
28	61	P52010173US	類比數位轉換器及其數位類比轉換器的電容權重估算法	獲證	美國	13/845,121	US8842027	20140923	20330317	經濟部技術處	
	62	P52010173TW	類比數位轉換器及其數位類比轉換器的電容權重估算法	獲證	中華民國	101151074	TWI497918	20150821	20321227	經濟部技術處	
29	63	P52000143US	逐次逼近暫存器類比數位轉換器及其線性度校正的方法	獲證	美國	13/343,725	US8487794	20130716	20320217	經濟部技術處	
	64	P52000143TW	逐次逼近暫存器類比數位轉換器及其線性度校正的方法	獲證	中華民國	100142894	TWI454065	20140921	20311122	經濟部技術處	
30	65	P52000099US	電荷域濾波器及其方法	獲證	美國	13/364,245	US8710920	20140429	20320228	經濟部技術處	
	66	P52000099TW	電荷域濾波器及其方法	獲證	中華民國	100146228	TWI478490	20150321	20311213	經濟部技術處	
	67	P52000099CN	電荷域濾波器及其方法	獲證	中國大陸	201210031192.3	CN103166594	20151007	20320208	經濟部技術處	
31	68	P52000078USD1	電荷域濾波器及其方法	獲證	美國	14/014,364	US8836417	20140916	20311222	經濟部技術處	
	69	P52000078US	電荷域濾波器及其方法	獲證	美國	13/335,945	US8558607	20131015	20311222	經濟部技術處	
	70	P52000078TW	電荷域濾波器及其方法	獲證	中華民國	100141848	TWI437817	20140511	20311115	經濟部技術處	
	71	P52000078CN	電荷域濾波器及其方法	獲證	中國大陸	201110447551.9	CN103117723	20150729	20311222	經濟部技術處	

(三) 半導體異質構裝：11案 25件

案次	件次	件編號	專利名稱	狀態	國家	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	契約運用
32	72	P52990137US	三維晶片的堆疊結構與堆疊方法	獲證	美國	12/986,184	US8710676	20140429	20310825	經濟部技術處	
33	73	P52000142USD1	以效能為導向的三維晶片互連冗餘方法與機制	獲證	美國	13/919,605	US8689160	20140401	20311215	經濟部技術處	
	74	P52000142US	以效能為導向的三維晶片互連冗餘方法與機制	獲證	美國	13/328,403	US8522186	20130827	20311215	經濟部技術處	
34	75	P51990138US	直通矽晶穿孔結構及其製程	獲證	美國	13/174,794	US8456017	20130604	20310726	經濟部技術處	
	76	P51990138TW	直通矽晶穿孔結構及其製程	獲證	中華民國	100114689	TWI436466	20140501	20310426	經濟部技術處	
35	77	P51990097US	三維立體堆疊晶片封裝結構	獲證	美國	13/154,423	US8618672	20131231	20320418	經濟部技術處	
	78	P51990097TW	三維立體堆疊晶片封裝結構	獲證	中華民國	99147323	TWI424552	20140121	20301230	經濟部技術處	
	79	P51990097CN	三維立體堆疊晶片封裝結構	獲證	中國大陸	201110034039.1	CN102543968	20141210	20310130	經濟部技術處	
36	80	P51990059US	多晶片堆疊結構	獲證	美國	12/968,285	US8581419	20131112	20310919	經濟部技術處	非專屬授權中
37	81	P51990048US	封裝單元及其堆疊結構與製造方法	獲證	美國	13/272,771	US8502378	20130806	20311225	經濟部技術處	非專屬授權中
	82	P51990048TW	封裝單元及其堆疊結構與製造方法	獲證	中華民國	99134969	TWI501365	20150921	20301012	經濟部技術處	非專屬授權中



案次	件次	件編號	專利名稱	狀態	國家	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	契約運用
38	83	P51980127US	電子元件封裝結構及其製造方法	獲證	美國	12/891,734	US8598686	20131203	20311220	經濟部技術處	
	84	P51980127TW	電子元件封裝結構及其製造方法	獲證	中華民國	99107774	TWI414047	20131101	20300316	經濟部技術處	
39	85	P51970133US	多組同軸導線於基材之單一通孔中之結構與其製作方法	獲證	美國	12/468,058	US8304666	20121106	20300819	經濟部技術處	曾非專屬授權
	86	P51970133TW	多組同軸導線於基材之單一通孔中之結構與其製作方法	獲證	中華民國	97151842	TWI393490	20130411	20281230	經濟部技術處	曾非專屬授權
40	87	P51010044US	雙相介金屬接點結構及其製作方法	獲證	美國	13/736,088	US8742600	20140603	20330107	經濟部技術處	非專屬授權中
	88	P51010044TW	雙相介金屬接點結構及其製作方法	獲證	中華民國	101137147	TWI466253	20141221	20321007	經濟部技術處	非專屬授權中
	89	P51010044CN	雙相介金屬互連結構及其製作方法	獲證	中國大陸	201210459988.9	CN103715178	20180410	20321114	經濟部技術處	非專屬授權中
41	90	P51000172US	晶片堆疊結構以及晶片堆疊結構的製作方法	獲證	美國	13/586,890	US8519524	20130827	20320815	經濟部技術處	
	91	P51000172TW	晶片堆疊結構以及晶片堆疊結構的製作方法	獲證	中華民國	101118718	TWI485826	20150521	20320524	經濟部技術處	
42	92	P03940024USD2	具樑柱結構之三維晶圓堆疊架構	獲證	美國	13/774,939	US9111774	20150818	20260619	工研院	
	93	P03940024USC1	具樑柱結構之三維晶圓堆疊架構	獲證	美國	12/982,046	US8810031	20140819	20261227	工研院	
	94	P03940024US	具樑柱結構之三維晶圓堆疊架構	獲證	美國	11/471,165	US8164165	20120424	20290628	工研院	
	95	P03940024TW	具樑柱結構之三維晶圓堆疊架構	獲證	中華民國	94137522	TWI285419	20070811	20251025	工研院	
	96	P03940024CN	具有梁柱結構之三維晶片堆疊結構及三維晶片堆疊的方法	獲證	中國大陸	200510120396.4	CN100495701	20090603	20251110	工研院	

(四) 軟性電子：2案4件

案次	件次	件編號	專利名稱	狀態	國家	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	契約運用
43	97	P51990077US	平面揚聲器單體及平面揚聲器裝置	獲證	美國	12/979,341	US8625824	20140107	20290225	經濟部技術處	非專屬授權中
44	98	P51010016US	感測器的讀取裝置與驅動方法	獲證	美國	13/620,732	US9074954	20150707	20330913	經濟部技術處	曾非專屬授權
	99	P51010016TW	感測器的讀取裝置與驅動方法	獲證	中華民國	101126061	TWI487883	20150611	20320718	經濟部技術處	曾非專屬授權
	100	P51010016CN	傳感器的讀取裝置與驅動方法	獲證	中國大陸	201210325624.1	CN103575433	20151216	20320904	經濟部技術處	曾非專屬授權

(五) 智慧製造與辨識：11案20件

案次	件次	件編號	專利名稱	狀態	國家	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	契約運用
45	101	P62950018TW	通訊系統及其相關之功率管理方法	獲證	中華民國	95142548	TWI331858	20101011	20261116	經濟部技術處	
46	102	P52990173US	適用於多核心平台的多核心同步除錯系統與方法	獲證	美國	13/108,942	US8522079	20130827	20320104	經濟部技術處	



案次	件次	件編號	專利名稱	狀態	國家	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	契約運用
47	103	P52990149US	基於人臉區域之位置與大小預估的人臉偵測方法與系統及電腦程式產品	獲證	美國	13/180,804	US8559707	20131015	20320612	經濟部技術處	非專屬授權中
48	104	P52990148TW	溫度感測裝置及方法	獲證	中華民國	99147342	TWI421478	20140101	20301230	經濟部技術處	
49	105	P52990136US	影像擷取裝置及其方法	獲證	美國	13/025,179	US8643753	20140204	20310714	經濟部技術處	曾非專屬授權
	106	P52990136TW	影像擷取裝置及其方法	獲證	中華民國	99144834	TWI458347	20141021	20301219	經濟部技術處	曾非專屬授權
50	107	P52990110USC1	事務層級之系統功率消耗評估方法與系統	獲證	美國	13/851,094	US8756544	20140617	20310306	經濟部技術處	非專屬授權中
	108	P52990110US	事務層級之系統功率消耗評估方法與系統	獲證	美國	13/041,443	US8510694	20130813	20310728	經濟部技術處	非專屬授權中
	109	P52990110CN	事務處理級的系統功率消耗估計方法與系統	獲證	中國大陸	201010622761.2	CN102486813	20131009	20301229	經濟部技術處	
51	110	P52040077US	通道估測的裝置與方法	獲證	美國	14/981,859	US9401825	20160726	20351227	經濟部技術處	
	111	P52040077TW	通道估測的裝置與方法	獲證	中華民國	104136425	TWI577158	20170401	20351104	經濟部技術處	
52	112	P52000174TW	鍵控移幅接收器	獲證	中華民國	100145557	TWI458297	20141021	20311208	經濟部技術處	
53	113	P52000172US	壞點偵測方法與電腦程式產品	獲證	美國	13/475,403	US8643751	20140204	20320822	經濟部技術處	
	114	P52000172TW	壞點偵測方法與電腦程式產品	獲證	中華民國	100144393	TWI456991	20141011	20311201	經濟部技術處	
54	115	P51990042USC1	測量裝置	獲證	美國	13/308,523	US8507909	20130813	20310327	經濟部技術處	
	116	P51990042US	測量裝置	獲證	美國	12/962,658	US8502224	20130806	20310327	經濟部技術處	
	117	P51990042CN	測量裝置	獲證	中國大陸	201110160053.6	CN102288335	20140423	20310614	經濟部技術處	
55	118	P51990030USD1	機械強度測試設備、半導體裝置的製造方法與測試方法	獲證	美國	13/769,824	US8673658	20140318	20310208	經濟部技術處	
	119	P51990030US	機械強度測試設備、半導體裝置的製造方法與測試方法	獲證	美國	13/023,545	US8397584	20130319	20310306	經濟部技術處	
	120	P51990030TW	機械強度測試設備、半導體裝置的製造方法與測試方法	獲證	中華民國	99141042	TWI405303	20130811	20301125	經濟部技術處	

(六) 取像與影像處理技術：15 案 27 件

案次	件次	件編號	專利名稱	狀態	國家	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	契約運用
56	121	P51990130US	量測方法與量測裝置	獲證	美國	13/197,739	US8767094	20140701	20320627	經濟部技術處	
	122	P51990130CN	量測方法與量測裝置	獲證	中國大陸	201110077221.5	CN102692207	20140730	20310324	經濟部技術處	
57	123	P51990076US	投影式立體顯示器及立體螢幕	獲證	美國	13/085,486	US8474980	20130702	20310425	經濟部技術處	
58	124	P51990074US	追蹤目標物的方法及裝置	獲證	美國	13/066,515	US8442269	20130514	20310802	經濟部技術處	曾非專屬授權
	125	P51990074TW	追蹤目標物的方法及裝置	獲證	中華民國	99147243	TWI394087	20130421	20301230	經濟部技術處	曾非專屬授權
59	126	P51990060US	前景深度地圖產生模組及其方法	獲證	美國	13/286,501	US8478024	20130702	20320131	經濟部技術處	



案次	件次	件編號	專利名稱	狀態	國家	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	契約運用
59	127	P51990060TWC1	前景深度地圖產生模組及其方法	獲證	中華民國	100124396	TWI469088	20150111	20310710	經濟部技術處	
60	128	P51990058US	影像處理的方法及裝置	獲證	美國	13/152,093	US8754891	20140617	20320826	經濟部技術處	曾非專屬授權
	129	P51990058TW	影像處理的方法及裝置	獲證	中華民國	99145926	TWI462053	20141121	20301223	經濟部技術處	曾非專屬授權
61	130	P51990055US	視頻數據處理系統以及方法	獲證	美國	12/979,963	US8619124	20131231	20320303	工研院	
62	131	P51990053US	時間多工多畫面平行播放立體顯示系統	獲證	美國	12/957,408	US8698880	20140415	20320410	經濟部技術處	
63	132	P51990033US	立體影像顯示器	獲證	美國	12/877,997	US8605137	20131210	20320514	經濟部技術處	
	133	P51990033TW	立體影像顯示器	獲證	中華民國	99135266	TWI434066	20140411	20301014	經濟部技術處	
	134	P51990033CN	立體影像顯示器	獲證	中國大陸	201010522920.1	CN102043253	20121114	20301019	經濟部技術處	
64	135	P51980110US	動畫產生系統及方法	獲證	美國	12/941,098	US8462198	20130611	20310823	經濟部技術處	
	136	P51980110TW	動畫產生系統及方法	獲證	中華民國	99110520	TWI434227	20140411	20300405	經濟部技術處	
65	137	P51980100US	產生多視角三維立體影像的方法及其裝置	獲證	美國	12/950,480	US8698797	20140415	20321116	經濟部技術處	曾非專屬授權
	138	P51980100TW	產生多視角三維立體影像的方法及其裝置	獲證	中華民國	99121946	TWI459796	20141101	20300701	經濟部技術處	曾非專屬授權
66	139	P51980089US	微型成像模塊、應用之立體顯示系統及影像排列方法	獲證	美國	12/841,741	US8723929	20140513	20320730	經濟部技術處	
	140	P51980089CN	微型成像模塊、應用之立體顯示系統及影像排列方法	獲證	中國大陸	200910266558.3	CN102109751	20130807	20291228	經濟部技術處	
67	141	P51980078US	自我定位裝置及其方法	獲證	美國	12/650,553	US8385683	20130226	20310328	經濟部技術處	
	142	P51980078TW	自我定位裝置及其方法	獲證	中華民國	98136414	TWI403690	20130801	20291025	經濟部技術處	
68	143	P51970137US	全域極小值的搜尋方法及系統	獲證	美國	12/534,861	US8457388	20130604	20320320	經濟部技術處	
	144	P51970137TW	全域極小值的搜尋方法及系統	獲證	中華民國	97151864	TWI413020	20131021	20281230	經濟部技術處	
69	145	P51970115US	濾波器設計方法、裝置與用濾波器還原影像的方法及裝置	獲證	美國	12/647,521	US8452115	20130528	20320109	經濟部技術處	
	146	P51970115TW	濾波器設計方法、裝置與用濾波器還原影像的方法及裝置	獲證	中華民國	98101785	TWI434228	20140411	20290116	經濟部技術處	
70	147	P51970023US	以資料庫為基礎之二維影像轉為三維影像內容之轉換方法、其電腦可讀取媒體以及影像轉換系統	獲證	美國	12/351,187	US8411932	20130402	20320202	經濟部技術處	



(七) 半導體光源：8 案 20 件

案次	件次	件編號	專利名稱	狀態	國家	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	契約運用
71	148	P51990116USC2	具有多功能用途的照明系統及其控制方法	獲證	美國	14/979,925	US9900956	20180220	20310919	經濟部技術處	曾非專屬授權
	149	P51990116USC1	具有多功能用途的照明系統及其控制方法	獲證	美國	14/485,886	US9578709	20170221	20310919	經濟部技術處	曾非專屬授權
	150	P51990116US	具有多功能用途的照明系統及其控制方法	獲證	美國	13/237,775	US8847508	20140930	20320807	經濟部技術處	曾非專屬授權
	151	P51990116TW	具有多功能用途的照明系統及其控制方法	獲證	中華民國	100103720	TWI545990	20160811	20310130	經濟部技術處	曾非專屬授權
72	152	P51990017US	無線充電系統	獲證	美國	12/833,218	US8692505	20140408	20301102	經濟部技術處	
73	153	P51980139US	發光單元陣列、用以製造其之方法及成像裝置	獲證	美國	13/212,212	US8573784	20131105	20300611	經濟部技術處	非專屬授權中
	154	P51980139TW	發光單元陣列、用以製造其之方法及成像裝置	獲證	中華民國	99134105	TWI424251	20140121	20301005	經濟部技術處	非專屬授權中
	155	P51980139CN	發光單元陣列、其製造方法和投影設備	獲證	中國大陸	201080010263.0	CN102341740	20150916	20300621	經濟部技術處	非專屬授權中
74	156	P51970144USC1	發光二極體封裝結構	獲證	美國	13/448,413	US8692274	20140408	20291007	經濟部技術處	
	157	P51970144US	發光二極體封裝結構	獲證	美國	12/575,470	US8178890	20120515	20300216	經濟部技術處	曾非專屬授權
	158	P51970144TWD1	發光二極體封裝結構	獲證	中華民國	102108058	TWI469402	20150111	20290223	經濟部技術處	
	159	P51970144TW	發光二極體封裝結構	獲證	中華民國	98105780	TWI413284	20131021	20290223	經濟部技術處	曾非專屬授權
	160	P51970144CN	發光二極管封裝結構	獲證	中國大陸	200910132740.X	CN101866995	20120808	20290415	經濟部技術處	曾非專屬授權
75	161	P51970124US	光學式人機互動裝置	獲證	美國	12/649,357	US8384682	20130226	20310423	經濟部技術處	
76	162	P51960104US	發光模組	獲證	美國	12/046,419	US8777437	20140715	20311025	經濟部技術處	
77	163	P51960038USD1	發光模組及其形成方法	獲證	美國	13/215,214	US8624274	20140107	20271105	經濟部技術處	
	164	P51960038US	發光模組及其形成方法	獲證	美國	11/979,568	US8022421	20110920	20290705	經濟部技術處	
	165	P51960038TW	發光模組及其形成方法	獲證	中華民國	97105189	TWI384611	20130201	20280213	經濟部技術處	
	166	P51960038CN	發光模塊及其形成方法	獲證	中國大陸	200810090916.5	CN101431051	20110413	20280331	經濟部技術處	
78	167	P51000007US	發光元件及發光元件的製作方法	獲證	美國	13/070,486	US8587017	20131119	20300503	經濟部技術處	

【備註】本讓與案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。